

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

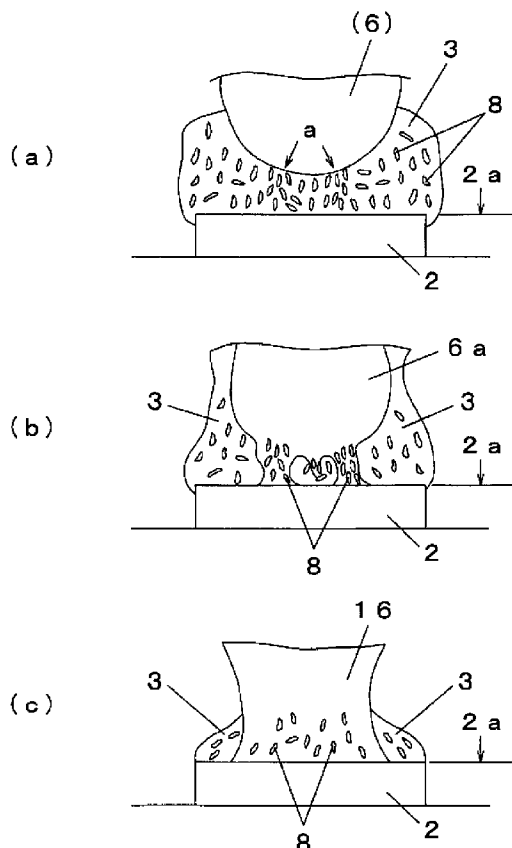
(10) 国際公開番号
WO 2005/072906 A1

- (51) 国際特許分類⁷: **B23K 35/363, 3/00,**
H05K 3/34 // B23K 101:42
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/001087
- (22) 国際出願日: 2005 年 1 月 27 日 (27.01.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-021090 2004 年 1 月 29 日 (29.01.2004) JP
特願 2004-327440
2004 年 11 月 11 日 (11.11.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 前田 憲 (MAEDA, Tadashi). 境 忠彦 (SAKAI, Tadahiko).
- (74) 代理人: 河宮 治, 外 (KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: SOLDERING FLUX AND SOLDERING METHOD

(54) 発明の名称: 半田付用のフラックスおよび半田付方法



8... METAL POWDER

8 金属粉

(57) Abstract: Disclosed is a soldering flux which enables to obtain a high-quality soldered joint without causing a joint defect or deterioration of insulation. Also disclosed is a soldering method using such a flux. When a first electrode provided with a solder portion is joined to a second electrode with solder, this soldering flux is interposed between the solder portion and the second electrode. This soldering flux comprises a liquid base material wherein a resin component is dissolved in a solvent, an active component having a function of removing oxide films, and a metal powder composed of a metal having a melting point higher than that of the solder portion; and the metal powder is contained in an amount of 1-9 vol%.

(57) 要約: 接合不良や絶縁性の低下を招くことなく高品質の半田接合部を得ることができる半田付用のフラックスおよびこのフラックスを用いた半田付方法を提供する。そのようなフラックスは、半田部が形成された第1の電極を第2の電極に半田付けする際に前記半田部と前記第2の電極の間に介在させる半田付用のフラックスであって、樹脂成分を溶剤に溶解した液状の基剤と、酸化膜を除去する作用を有する活性成分と、前記半田部の融点よりも高い融点を有する金属から成る金属粉とを含んで成り、前記金属粉を1～9 vol%の範囲で含有する。

WO 2005/072906 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書